

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考之用，概不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED

華虹半導體有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1347)

**(1) 有關合營協議、合營投資協議及土地轉讓協議的主要交易
及**

(2) 有關土地轉讓協議的關連交易

合營協議及合營投資協議

本公司、華虹宏力、國家集成電路產業基金II及無錫市實體於二零二三年一月十八日訂立合營協議，據此（其中包括），本公司、華虹宏力、國家集成電路產業基金II及無錫市實體有條件同意透過合營公司成立合營企業並以現金方式分別向合營公司投資880.38百萬美元、1,169.82百萬美元、1,165.8百萬美元及804百萬美元。

根據合營協議，合營公司將從事集成電路及採用65/55nm至40nm工藝的12英寸(300mm)晶圓的製造及銷售。

關於合營協議，合營股東亦將訂立合營公司的新組織章程細則以反映根據合營協議協定的條款。

同日，本公司、華虹宏力、國家集成電路產業基金II、無錫市實體及合營公司訂立合營投資協議以將合營公司轉為合營企業並將合營公司的註冊資本由人民幣6.68百萬元增至40.2億美元。

合營公司將於合營協議及合營投資協議項下擬進行的交易完成後成為本公司的非全資子公司。根據合營協議及合營投資協議，向中國政府完成相關備案後，合營公司將由本集團持有約51%權益，其中21.9%將由本公司直接持有及29.1%將由本公司透過其全資子公司華虹宏力間接持有。

土地轉讓協議

合營公司與華虹無錫於二零二三年一月十八日訂立土地轉讓協議，據此，華虹無錫有條件同意轉讓，而合營公司有條件同意以總代價人民幣170,100,450.00元購買該土地，以開發晶圓廠，從而容納合營公司製造集成電路及12英寸(300mm)晶圓的生產線。轉讓的完成須待(其中包括)合營股東向合營公司注入第一筆資金後方可作實。

上市規則的涵義

根據第14.04(1)(f)條，成立合營企業構成上市規則第十四章項下的須予公佈交易。由於(i)華虹無錫注資協議(先前於本公司日期為二零二二年六月二十九日的公告中披露)；(ii)合營協議；(iii)合營投資協議；及(iv)土地轉讓協議由大致相同的訂約方(即本公司、華虹宏力、華虹無錫、合營公司及／或國家集成電路產業基金II)或該等訂約方持有股權的公司出於加強本公司在12英寸(300mm)晶圓市場的地位的相同目的而訂立，該等交易將根據上市規則第14.22條合併計算及處理，猶如其為同一交易，以計算相關百分比率。

由於與(i)華虹無錫注資協議；(ii)合營協議；(iii)合營投資協議；及(iv)土地轉讓協議相關的上市規則第14.07條項下的一項或多項適用百分比率高於25%但均低於100%，故上述交易根據上市規則第十四章構成須遵守公告、通函及股東批准規定的主要交易。

於本公告日期，華虹無錫為本公司的非全資子公司，由本公司主要股東國家集成電路產業基金持有約20.58%權益。因此，華虹無錫為本公司的關連子公司，而訂立土地轉讓協議根據上市規則第十四A章構成本公司的關連交易。

由於與土地轉讓協議相關的一項或多項適用百分比率(定義見上市規則)高於0.1%但低於5%，故訂立土地轉讓協議須遵守申報及公告規定，但按單獨基準獲豁免遵守上市規則第十四A章項下通函及獨立股東批准規定。鑒於上述原因，為免生疑問，土地轉讓協議與合營協議及合營投資協議合併仍須根據上市規則第十四章於股東特別大會上獲股東批准。

總投資額： 合營公司於其業務的總投資將為67億美元，乃由合營協議所有訂約方基於須為合營協議項下擬進行的業務撥資經公平磋商後釐定。

總投資額67億美元中的40.2億美元將由合營股東以股本出資方式撥資，餘下總投資額（即26.8億美元）將以債務融資方式籌資。

註冊資本： 合營公司的註冊資本將為40.2億美元。

合營股東投資承擔： 本公司、華虹宏力、國家集成電路產業基金II及無錫市實體已同意分別向合營公司投資880.38百萬美元、1,169.82百萬美元、1,165.8百萬美元及804百萬美元，該等投資將以等值人民幣現金提供。為免生疑，華虹宏力的投資包括註冊成立合營公司的初始資本人民幣6.68百萬元。

投資承擔總額由合營股東參考合營公司的資金需求（尤其是12英寸(300mm)晶圓廠的建設成本）以及各合營股東認購的有關股本經公平磋商後釐定。

向中國政府完成相關備案後，合營公司的註冊資本將由人民幣6.68百萬元增至40.2億美元，而合營公司將分別由本公司、華虹宏力、國家集成電路產業基金II及無錫市實體擁有21.9%、29.1%、29%及20%權益。

各合營股東已同意以三(3)筆獨立付款投資於合營公司：

- (i) 第一筆付款約為彼等各自投資承擔的15%，最遲於二零二三年三月三十一日支付，須待合營股東達成下文所載先決條件（合營協議明確規定的無法獲豁免的條件除外）及／或獲得書面豁免後方可作實；
- (ii) 第二筆付款約為彼等各自投資承擔的60%，將於各合營股東全數支付第一筆付款後九(9)個月內（或所有合營股東一致批准的有關其他時間）支付，須待合營股東達成下文所載先決條件及／或獲得書面豁免後方可作實；

- (iii) 第三筆及最後一筆付款約為彼等各自投資承擔的25%，將於各合營股東全數支付第二筆付款後的三(3)個月內支付，須待合營股東達成下文所載先決條件及／或獲得書面豁免後方可作實。

儘管有前述規定，在達成每筆付款的先決條件(如有)的前提下，合營公司獲得合營股東一致同意後，可根據實際資金需求調整每筆付款的比例及時間，在該情況下，合營協議及合營公司的組織章程細則亦應作相應修訂。

先決條件：

第一筆付款

各合營股東作出的第一筆付款(即彼等各自投資承擔的15%)須待合營股東達成(其中包括)以下條件及／或獲得書面豁免後，方可作實(如適用)：

- (i) 各合營股東各自取得合營協議及合營投資協議項下擬進行的交易的內部批准；
- (ii) 本公司就合營協議及合營投資協議項下擬進行的交易於股東特別大會上取得股東批准；
- (iii) 完成向中國國家市場監督管理總局作出所有有關(其中包括)合營公司董事委任及註冊資本變更的備案；及
- (iv) 經中國地方發展和改革委員會批准成立合營公司以從事合營業務。

為免生疑，本公司根據上市規則第十四章及第十四A章按照上述條件(i)及(ii)尋求內部批准及股東批准的責任不得獲豁免。

第二筆付款

各合營股東作出的第二筆付款（即彼等各自投資承擔的60%）須待合營股東達成（其中包括）以下條件及／或獲得書面豁免後，方可作實（如適用）：

- (i) 各合營股東已妥善及全數支付彼等各自對合營公司的投資承擔的第一期付款；
- (ii) 合營公司已完成必要的登記並取得與國有財產有關的證書及／或許可證；及
- (iii) 本公司已完成人民幣股份發行及人民幣股份在科創板上市。

第三筆付款

各合營股東作出的第三筆及最後一筆付款（即彼等各自投資承擔的25%）須待（其中包括）各合營股東已妥善及全數支付彼等各自對合營公司的投資承擔的第二期付款後，方可作實。

企業管治：

董事會及高級管理層

- (i) 合營公司董事會將由七(7)名董事組成，其中三(3)名將由本公司及／或華虹宏力委任，兩(2)名將由國家集成電路產業基金II委任，一(1)名將由無錫市實體委任，而一(1)名將為將於僱員中選舉的合營公司僱員代表。除僱員代表外，所有董事均由股東大會委任。各合營股東承諾在相關股東大會上投票贊成委任其他合營股東提名的有關董事。倘合營股東擬罷免其提名的任何董事，則有關董事應在股東大會上罷免，且各合營股東承諾在相關股東大會上投票贊成有關罷免。

- (ii) 合營公司將設立監事會，由六(6)名成員組成，其中兩(2)名將由本公司及／或華虹宏力委任，兩(2)名則由國家集成電路產業基金II及無錫市實體各自委任一人，而兩(2)名將為將於僱員中選舉的合營公司僱員代表。除僱員代表外，所有監事均由股東大會委任。各合營股東承諾在相關股東大會上投票贊成委任其他合營股東提名的有關監事。倘合營股東擬罷免其提名的任何監事，有關監事應在股東大會上罷免，且各合營股東承諾在相關股東大會上投票贊成有關罷免。
- (iii) 本公司及／或華虹宏力將提名一名彼等提名的董事擔任合營公司董事會主席。
- (iv) 國家集成電路產業基金II及無錫市實體將共同提名候選人擔任合營公司監事會主席。
- (v) 本公司及／或華虹宏力將提名合營公司總經理，總經理將提名合營公司高級管理層成員。
- (vi) 本公司及／或華虹宏力將提名合營公司財務副總經理。
- (vii) 國家集成電路產業基金II及無錫市實體均有權就合營公司及／或其子公司的營運及管理提出建議並與合營公司、本公司及／或華虹宏力進行磋商。合營公司、本公司及／或華虹宏力須合理(i)考慮國家集成電路產業基金II及無錫市實體的建議及(ii)在股東大會及／或董事會會議的監督下相應執行有關建議(倘適用及合理)。

保留事項

以下事項須取得出席董事會會議的合營公司全體董事或彼等授權代理人批准（及於法律要求時，須在股東大會上獲得合營公司股東的批准）（其中包括）：

- (i) 合營公司月產能12英寸(300mm)晶圓的任何重大變動；
- (ii) 合營公司及／或其任何控制實體發行任何債券或融資工具（銀行貸款除外）；
- (iii) 合營公司及／或其任何控制實體業務範圍的任何重大變動；
- (iv) 合營公司及／或其任何控制實體註冊資本的任何變動；
- (v) 合營公司及／或其任何控制實體的任何合併、撤資或重組；
- (vi) 合營公司及／或其任何控制實體的組織章程細則或註冊股本的任何變動；及
- (vii) 合營公司及／或其任何控制實體控制的任何實體的任何設立、解散或出售，或將導致合營公司獲得對目標實體的控制權的任何合併或收購。

以下事項須取得出席董事會會議的合營公司全體董事的三分之二批准（其中包括）：

- (i) 超過合營公司及／或其任何控制實體年度預算或年度經營計劃的任何財政年度內按單獨基準超過20百萬美元或按合共基準超過50百萬美元的任何費用；
- (ii) 合營公司及／或其任何控制實體提起或解決任何訴訟或仲裁，其中涉及金額於12個月期間內按單獨基準超過合營公司根據最近期經審核賬目內計算的資產淨值的1%（或合營公司於其成立後第一個財政年度內註冊資本的1%）或按合共基準超過合營公司根據最近期經審核賬目內計算的資產淨值的3%（或合營公司於其成立後第一個財政年度內註冊資本的3%）；及

- (iii) 任何財政年度內合營公司及／或其任何控制實體的日常業務過程以外收購、出售或以其他方式處置資產，金額超過10百萬美元（根據採購價或賬面淨值計算，無論按單獨或合共基準）。

組織章程細則

關於合營協議，合營股東亦將訂立合營公司的新組織章程細則。

轉讓限制： 根據轉讓通知的條款及條件，各合營股東有權行使其優先購買權，以購買另一名合營股東按其當時於合營公司的現有股權比例擬向任何第三方（既非合營股東亦非其聯屬人士）轉讓的任何合營公司股權。

不競爭承諾： 本公司及華虹宏力不會並將促使彼等各自的聯屬人士（合營公司及／或其直接或間接控制的任何實體除外）在65/55nm以下（不包括65/55nm）及40nm的12英寸（300mm）晶圓業務方面不會與合營公司展開競爭。

為免生疑問，根據日期為二零一八年一月三日內容有關成立華虹無錫的合營協議，華虹宏力及本公司以華虹無錫為受益人作出的不競爭承諾僅涵蓋採用90nm以下（不包括90nm）至65nm工藝的12英寸（300mm）晶圓的業務，這與上文以合營公司為受益人的不競爭承諾並無重疊。有關進一步詳情，請參閱本公司日期為二零一八年一月三十日的通函。

條款： 自合營公司營業執照頒發日期起計50年

2. 合營投資協議

本公司、華虹宏力、國家集成電路產業基金II、無錫市實體及合營公司於二零二三年一月十八日訂立合營投資協議以將合營公司轉為合營企業並將合營公司的註冊資本由人民幣6.68百萬元增至40.2億美元。

合營投資協議的主要條款如下：

日期： 二零二三年一月十八日

訂約方： (i) 本公司；

 (ii) 華虹宏力，本公司的全資子公司；

 (iii) 國家集成電路產業基金II；

 (iv) 無錫市實體；及

 (v) 合營公司。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，無錫市實體、國家集成電路產業基金II及彼等各自最終實益擁有人(如有)為本公司的獨立第三方。

認購資本： 合營公司的註冊資本將由人民幣6.68百萬元增至40.2億美元。

考慮到本公司、華虹宏力、無錫市實體及國家集成電路產業基金II的出資，合營公司將向上述認購合營股東均發行合營公司股本。

根據合營投資協議，規管各訂約方認購合營公司註冊資本的條款與合營協議所載者相同。有關此認購的詳情，請參閱上文合營協議條款概要「投資承擔」。

其他條款： 合營公司將轉為合營企業。增資須待(其中包括)股東於股東特別大會上批准及中國有關登記及備案完成(如合營投資協議所載)後，方可作實。

3. 土地轉讓協議

合營公司及華虹無錫於二零二三年一月十八日訂立土地轉讓協議，據此，華虹無錫有條件同意將土地轉讓予合營公司。

土地轉讓協議的主要條款如下：

- 日期：二零二三年一月十八日
- 訂約方：(i) 合營公司；及
(ii) 華虹無錫
- 標的事項：位於中國江蘇省無錫市新洲路28及30號及錫興路27及29號249,049平方米的多幅土地的部分土地使用權
- 總代價：人民幣170,100,450.00元（即每平方米約人民幣683元）（不包括稅項）
- 代價基準：土地轉讓協議下的代價乃由訂約方按照中國合資格資產估值師根據(i)市場法及(ii)基準地價修正法編製的估值報告所載的二零二二年九月三十日的土地估值（即人民幣170,100,450.00元）經公平磋商釐定及同意。根據估值報告，於二零二二年九月三十日，該土地的土地使用權帳面值為人民幣137,659,824.65元。
- 原收購成本：華虹無錫最初於二零一八年自當時中國國土資源部收購的土地連同附近的其他地塊，總面積為466,456.1平方米，按每平方米人民幣570元計，總代價為人民幣265,880,000元。
- 先決條件：轉讓須待（其中包括）以下條件獲達成及／或獲豁免（倘適用）後，方可作實：
- (i) 華虹無錫及合營公司均已就土地轉讓協議項下擬進行的交易獲得彼等各自內部批准；
- (ii) 本公司已於股東特別大會上就土地轉讓協議項下擬進行的轉讓取得其股東的批准；

- (iii) 合營股東均已根據合營協議及合營投資協議向合營公司及時悉數地支付彼等各自的第一筆投資承擔；
- (iv) 華虹無錫已就建議轉讓獲得該土地承押人的同意；
- (v) 合營公司已按照土地轉讓協議的條款於特定先決條件獲達成後五個營業日內向華虹無錫支付總代價；及
- (vi) 華虹無錫及合營公司均已就該土地與中國相關政府部門完成相關登記及備案。

為免生疑問，本公司、華虹無錫及合營公司遵守上市規則第十四及十四A章於上述條件(i)及(ii)項下尋求內部批准及股東批准的責任為不可豁免。

支付條款： 合營公司應於上述(i)至(iv)項的所有先決條件獲達成後五個營業日內以現金方式向華虹無錫支付總代價。

4. 訂立合營協議、合營投資協議及土地轉讓協議之理由及裨益

(i) 合營協議及合營投資協議

儘管華虹無錫持續進行產能擴充，但鑒於近年來對半導體的需求依舊強勁，其無法滿足市場增長。華虹無錫的晶圓廠產能利用率保持在一個非常高的水平。

於本公司日期為二零二二年六月二十九日的公告中披露及於二零二二年八月二十九日舉行的股東特別大會上獲股東批准的華虹無錫增資後，本公司希望進一步擴大其12英寸(300mm)晶圓業務，並深化其與國家集成電路產業基金II的合作，以設立另一家合營公司。連同合營協議及合營投資協議，本集團及華虹無錫的專業知識可使合營公司在未來幾年滿足強勁的市場需求。本公司及華虹宏力於合營公司的投資承擔將主要由建議人民幣股份發行的所得款項貢獻，該所得款項已在本公司日期為二零二二年六月七日的通函中披露，並於二零二二年六月二十七日舉行的股東特別大會上獲股東批准。本公司期盼抓住並利用這一具有吸引力且重大的市場機遇，以進一步推動未來幾年的業務增長。

鑒於華虹無錫的強勁表現及本公司「8英寸+12英寸」的企業戰略，本公司於二零二三年將繼續擴大其生產線的產能。合營協議及合營投資協議符合本公司的戰略，以強化其在各類晶圓領域的市場地位及競爭力。

(ii) 土地轉讓協議

華虹無錫最初於二零一八年收購該土地，以利於其業務的未來發展及擴張。隨著本公司通過成立合營公司，進一步加強與國家集成電路產業基金II(一家經驗豐富的集成電路行業投資者)的合作，本公司決定充分利用其土地儲備，在集團內部將該土地自華虹無錫轉讓予合營公司。董事認為，土地轉讓將為合營公司未來建設12英寸(300mm)晶圓生產的晶圓廠奠定基礎，並為開展合資業務的重要第一步。

(iii) 董事意見

經審閱合營協議、合營投資協議及土地轉讓協議的條款後，董事(包括獨立非執行董事)認為：

- (a) 合營協議、合營投資協議及土地轉讓協議的條款屬公平合理，且按一般商業條款或更佳條款訂立；及
- (b) 合營協議、合營投資協議及土地轉讓協議乃於本公司一般及日常業務過程中訂立，且符合本公司及其股東的整體利益。

5. 有關訂約方的資料

本公司

本公司主要專注於嵌入式非易失性存儲器、功率器件、模擬及電源管理和邏輯及射頻等特色工藝製造平台。

華虹宏力

華虹宏力為於二零一三年一月二十四日在中國註冊成立的外資企業，並為本公司的全資子公司。華虹宏力的主要業務為作為純晶圓代工廠研發、製造及銷售半導體。

合營公司

合營公司於二零二二年六月十七日在中國正式成立，目前為本公司的間接全資子公司。作為特殊目的公司，於本公告日期，由於其尚未經營任何業務，故除根據土地轉讓協議購買該土地的土地使用權的有條件權利外並無任何資產。

根據合營協議及合營投資協議，向中國政府完成相關備案後，合營公司將由本集團持有約51%權益，其中21.9%將由本公司直接持有及29.1%將由本公司透過其全資子公司華虹宏力間接持有。

國家集成電路產業基金II

國家集成電路產業基金II主要透過股權投資於集成電路產業價值鏈進行投資，其中以集成電路芯片生產及芯片設計、封裝測試以及設備及材料為主。於本公告日期及根據國家集成電路產業基金II提供的資料，國家集成電路產業基金II的二十七名基金投資者載列如下：

基金投資者	佔股權百分比
財政部#	11.02%
國開金融有限責任公司#	10.78%
重慶戰略性新興產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)	7.35%
成都天府國集投資有限公司	7.35%
武漢光谷金融控股集團有限公司	7.35%
浙江富浙集成電路產業發展有限公司	7.35%
中國煙草總公司#	7.35%
上海國盛(集團)有限公司#	7.35%

基金投資者	佔股權百分比
北京亦莊國際投資發展有限公司#	4.90%
江蘇惠泉集成電路產業投資有限公司	4.90%
北京國誼醫院有限公司	4.90%
中移資本控股有限責任公司	4.90%
安徽省芯火集成電路產業投資合夥企業(有限合夥)	3.67%
安徽皖投安華現代產業投資合夥企業(有限合夥)	3.67%
廣州產業投資基金管理有限公司	1.47%
福建省國資集成電路投資有限公司	1.47%
深圳市深超科技投資有限公司	1.47%
黃埔投資控股(廣州)有限公司	0.98%
中國電信集團有限公司#	0.73%
聯通資本投資控股有限公司	0.49%
中國電子信息產業集團有限公司#	0.24%
華芯投資#	0.07%
上海矽啓企業管理合夥企業(有限合夥)	0.05%
北京建廣資產管理有限公司	0.05%
福建三安集團有限公司#	0.05%
北京紫光通信科技集團有限公司#	0.05%
協鑫資本管理有限公司	0.05%
總計：	100.00%

附註：#指國家集成電路產業基金與國家集成電路產業基金II的重疊股東。

國家集成電路產業基金II不被視為其單一最大股東財政部的子公司。概無控制(直接或間接)國家集成電路產業基金II三分之一或以上股權的最終實益擁有人。國家集成電路產業基金II由華芯投資進行管理。華芯投資(作為股東而非基金管理人)於國家集成電路產業基金II股東大會的投票權與其於國家集成電路產業基金II所持股權成比例。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，董事認為，且國家集成電路產業基金及國家集成電路產業基金II均確認：

- (1) 國家集成電路產業基金II為本公司獨立第三方，因其於本公告日期僅持有華虹無錫8.42%的股權而因此不被視為子公司層面的關連人士；及
- (2) 華芯投資對國家集成電路產業基金及國家集成電路產業基金II並無控制權，原因為(i)並無直接或間接控制國家集成電路產業基金II的最終實益擁有人；(ii)國家集成電路產業基金及國家集成電路產業基金II均不被視為彼等單一最大股東的子公司；(iii)國家集成電路產業基金及國家集成電路產業基金II的十三名重疊股東概無可對國家集成電路產業基金及國家集成電路產業基金II行使多數控制權；及(iv)華芯投資根據其與國家集成電路產業基金及國家集成電路產業基金II分別訂立的授權，對國家集成電路產業基金及國家集成電路產業基金II的投資進行管理。特別是，根據華芯投資的資料，國家集成電路產業基金及國家集成電路產業基金II設立了獨立的投資政策及管理流程，委任獨立委員會成員加入彼等各自的投資委員會，以確保投資決策的獨立性，並且各自擁有單獨賬目，進行獨立的財務會計處理。

有基於此，根據上市規則第十四A章，本公司確認國家集成電路產業基金II並非為國家集成電路產業基金的聯繫人。

根據國家集成電路產業基金II提供的資料及就本公司所知，國家集成電路產業基金II為集成電路行業經驗豐富的投資者，且其作為相關實體的主要股東或(於若干情形下為)控股股東，已投資於集成電路製造領域的多家上市及非上市公司，其中可能包括從事與本公司、華虹無錫及／或擬由合營公司承擔的合營業務構成競爭業務的實體。除該等投資外，根據國家集成電路產業基金II的確認及就本公司所知，國家集成電路產業基金II本身並無從事與本公司、華虹無錫及／或擬由合營公司承擔的合營業務構成競爭的任何其他業務。

無錫市實體

無錫市實體為一家由市屬及區級國企聯合控制的專業投資公司，主要從事無錫的半導體重大項目股權投資。於本公告日期，無錫市實體由雲南國際信託有限公司持有45%權益、無錫國聯實業投資集團有限公司持有19.50%權益、無錫市國發資本運營有限公司持有19.00%權益及無錫產業發展集團有限公司持有16.50%權益。於本公告日期，根據無錫市實體提供的資料及就本公司所知，無錫市實體最終由無錫市國有資產監督管理委員會擁有55%權益。

6. 上市規則的涵義

根據第14.04(1)(f)條，成立合營企業構成上市規則第十四章項下的須予公佈交易。由於(i)華虹無錫注資協議；(ii)合營協議；(iii)合營投資協議；及(iv)土地轉讓協議由大致相同的訂約方(即本公司、華虹宏力、華虹無錫、合營公司及／或國家集成電路產業基金II)或該等訂約方持有股權的公司出於加強本公司在12英寸(300mm)晶圓市場的地位的相同目的而訂立，該等交易將根據上市規則第14.22條合併計算及處理，猶如其為同一交易，以計算相關百分比率。

由於與(i)華虹無錫注資協議(先前於本公司日期為二零二二年六月二十九日的公告中披露)；(ii)合營協議；(iii)合營投資協議；及(iv)土地轉讓協議相關的上市規則第14.07條項下的一項或多項適用百分比率高於25%但均低於100%，故上述交易根據上市規則第十四章構成須遵守公告、通函及股東批准規定的主要交易。

於本公告日期，華虹無錫為本公司的非全資子公司，由本公司主要股東國家集成電路產業基金持有約20.58%權益。因此，華虹無錫為本公司的關連子公司，而訂立土地轉讓協議根據上市規則第十四A章構成本公司的關連交易。

由於與土地轉讓協議相關的一項或多項適用百分比率(定義見上市規則)高於0.1%但低於5%，故訂立土地轉讓協議須遵守申報及公告規定，但按單獨基準獲豁免遵守上市規則第十四A章項下通函及獨立股東批准規定。鑒於上述原因，為免生疑問，土地轉讓協議與合營協議及合營投資協議合併仍須根據上市規則第十四章於股東特別大會上獲股東批准。

7. 股東特別大會、董事會會議及通函

本公司將召開股東特別大會，以審議及(如視為適當)批准(其中包括)合營協議、合營投資協議及土地轉讓協議。

通函載有(其中包括)合營協議、合營投資協議及土地轉讓協議的進一步詳情，連同召開股東特別大會的通告，由於本公司需要更多時間完成其中的內容，預期將於二零二三年三月前寄發予股東。

鑒於(a)華虹無錫於本公告日期由國家集成電路產業基金持有20.58%權益，且為土地轉讓協議項下的轉讓人，及(b)華芯投資為國家集成電路產業基金的基金管理人，

- (i) 國家集成電路產業基金之全資子公司鑫芯(香港)投資有限公司被認為於土地轉讓協議中擁有重大權益並就於股東特別大會上將提呈的批准土地轉讓協議之普通決議案放棄投票。於本公告日期，鑫芯(香港)投資有限公司持有178,705,925股股份，佔已發行股份總數的約13.67%。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，除鑫芯(香港)投資有限公司外，概無其他股東須於股東特別大會上就批准合營協議、合營投資協議及土地轉讓協議的決議案放棄投票；及
- (ii) 本公司非執行董事孫國棟先生現任華芯投資的董事總經理，因此，為避免潛在利益衝突，彼於授權訂立土地轉讓協議的董事會會議上放棄投票。除孫國棟先生外，概無董事須於董事會會議上就批准合營協議、合營投資協議及土地轉讓協議放棄投票。

合營協議、合營投資協議及土地轉讓協議須待合營協議、合營投資協議及土地轉讓協議(包括於股東特別大會上獲得股東的批准)所載的若干先決條件達成(或獲豁免)後方可作實，因此可能會或可能不會進行。建議本公司股東及有意投資者於買賣股份時審慎行事。

釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「國家集成電路產業基金」	指	國家集成電路產業投資基金股份有限公司，一家於二零一四年九月二十六日在中國註冊成立的公司並為本公司主要股東
「國家集成電路產業基金II」	指	國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司，一家於二零一九年十月二十二日在中國成立的公司
「本公司」	指	華虹半導體有限公司，一家在香港註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義

「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司召開的股東特別大會，以批准(其中包括)合營協議、合營投資協議及土地轉讓協議
「本集團」	指	本公司及其子公司
「華虹宏力」	指	上海華虹宏力半導體製造有限公司，一家於二零一三年一月二十四日在中國註冊成立的公司，為本公司的全資子公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「華虹無錫」	指	華虹半導體(無錫)有限公司，一家於二零一七年十月十日在中國註冊成立的公司，本公司非全資子公司
「華虹無錫注資協議」	指	由本公司、華虹宏力、無錫錫虹聯芯投資有限公司、國家集成電路產業基金、國家集成電路產業基金II及華虹無錫訂立的日期為二零二二年六月二十九日的注資協議，據此，上述各方(國家集成電路產業基金及華虹無錫除外)向華虹無錫注資合共800百萬美元
「獨立第三方」	指	根據上市規則第十四A章並非為本公司關連人士的人士
「合營協議」	指	本公司、華虹宏力、國家集成電路產業基金II及無錫市實體訂立的日期為二零二三年一月十八日的合營協議，旨在設立合營企業以開展合營業務
「合營業務」	指	合營公司將從事的集成電路的製造及銷售(包括採用65/55nm至40nm工藝生產12英寸(300mm)晶圓)
「合營公司」	指	華虹半導體製造(無錫)有限公司，一家於二零二二年六月十七日在中國註冊成立的公司，用於合營業務，其註冊資本目前由華虹宏力持有100%，根據合營協議及合營投資協議，向中國政府完成相關備案後將由本公司、華虹宏力、國家集成電路產業基金II及無錫市實體分別擁有約21.9%、29.1%、29%及20%

「合營投資協議」	指	由合營股東及合營公司訂立的日期為二零二三年一月十八日的投資協議，據此，合營股東同意將合營公司的註冊資本增至40.2億美元
「合營股東」	指	本公司、華虹宏力、國家集成電路產業基金II及無錫市實體
「該土地」	指	位於中國江蘇省無錫市新洲路28及30號及錫興路27及29號的多幅土地，為土地轉讓協議的標的事項
「土地轉讓協議」	指	由合營公司及華虹無錫訂立的日期為二零二三年一月十八日的土地轉讓協議，據此，華虹無錫有條件同意轉讓，合營公司有條件同意購買該土地，總代價為人民幣170,100,450.00元
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國（惟僅就本公告而言，不包括香港、澳門及台灣）
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「人民幣股份」	指	將由目標認購人在中國境內以人民幣認購並在科創板上市及以人民幣買賣的普通股
「人民幣股份發行」	指	本公司建議發行人民幣股份，其詳情載於本公司日期為二零二二年六月七日的通函
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股份
「華芯投資」	指	華芯投資管理有限責任公司，為國家集成電路產業基金及國家集成電路產業基金II的基金管理人。其最終實益擁有人為國開金融有限責任公司，為本公司的獨立第三方
「科創板」	指	上交所科創板
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「美元」	指	美元，美國法定貨幣

「估值報告」	指	於二零二二年九月三十日有關該土地價值的評估報告
「無錫市實體」	指	無錫錫虹國芯投資有限公司，一家由市屬及區級國企聯合控制的專業投資公司
「%」	指	百分比

承董事會命
華虹半導體有限公司
 董事長兼執行董事
 張素心先生

香港，二零二三年一月十八日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

張素心 (董事長)

唐均君 (總裁)

非執行董事

孫國棟

王靖

葉峻

獨立非執行董事

張祖同

王桂壘，太平紳士

葉龍蜚